

盛合晶微半导体有限公司
(SJ Semiconductor Corporation)
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“盛合晶微”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕373号）。发行人的股票简称为“盛合晶微”，扩位简称为“盛合晶微”，股票代码为“688820”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中信证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.68元/股，发行数量为25,546.6162万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为7,663.9848万股，占本次发行数量的30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定

的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为6,938.7770万股，占本次发行数量的27.16%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额725.2078万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为15,031.3392万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.78%；网上发行数量为3,576.5000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的19.22%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共18,607.8392万股。

根据《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,128.01倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,860.8000万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,170.5392万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.78%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为11,852.9643万股，网下有锁定期部分最终发行数量为1,317.5749万股；网上最终发行数量为5,437.3000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.22%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03682856%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月13日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次

公开发行人证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

- 1、高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
- 2、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
- 3、参与跟投的保荐人相关子公司。

截至2026年4月3日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。中金公司已在2026年4月15日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	投资者类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行数 量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	海光信息技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
2	中微半导体（上海）有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
3	上海天数智芯半导体股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
4	北京摩笔生成科技有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
5	沐曦数智（上海）科技有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
6	北京电控产业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,319,105	1.69%	84,999,986.40	12
7	聚辰半导体股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	1.19%	59,999,990.40	12
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	1.19%	59,999,990.40	12
9	联芸科技（杭州）股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	1.19%	59,999,990.40	12
10	北京昂瑞微电子技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	0.99%	49,999,992.00	12
11	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	0.99%	49,999,992.00	12

12	上海华虹宏力半导体制造有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	0.99%	49,999,992.00	12
13	翱捷科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,778,455	0.70%	34,999,994.40	12
14	中国中金财富证券有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	5,109,323	2.00%	100,551,476.64	24
15	中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划	高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	16,006,097	6.27%	314,999,988.96	36
合计			69,387,770	27.16%	1,365,551,313.60	-

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：54,198,222股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,066,621,008.96元
- 3、网上投资者放弃认购数量：174,778股
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,439,631.04元

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：131,705,392股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：2,591,962,114.56元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0.00元

二、保荐人（联席主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由中金公司包销，中金公司包销股份的数量为174,778股，包销金额为3,439,631.04元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.09%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.07%。

2026年4月15日（T+4日），中金公司将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份

登记至中金公司指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为24,897.30万元，明细如下：

1、保荐承销费用：19,984.61万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费：2,745.40万元，费用以工作人员的工作量为基础计算，按照项目进度分节点支付，付款节点根据工作量情况协商确定；

3、律师费：1,590.00万元，费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定，按照项目进度分节点支付；

4、信息披露费用：535.00万元；

5、上市相关的手续费等其他费用：42.29万元

注：以上费用均已包含增值税

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620582

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

电话：0755-23835515、0755-23835516

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2026年4月15日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）



2021年4月15日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司 (SJ Semiconductor Corporation)
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

